产品规格书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客　　戶（Client）：
品　　名 (Product name)：　无铅低温锡膏
品　　牌 （Brand）：　绿色时代牌
规　　格 (Specification)：　**Sn42/Bi58**
产　　地 (Origin)：中国.深圳
制 作 日 期 (Manufacture the date)：

客户确认 Client Confirmation	营业责任者 Business Conductor	技术责任者 Technology Conductor	发行 Publish
	李振豪	王志鵬	

保质期(Shelf life)：180 天

雲錫錦春錫業（集團）有限公司

深圳市绿色时代锡业制品有限公司

全国统一服务热线：4000-555-964

公司地址：深圳市宝安区龙华大浪南路墩背工业区龙苑大道 62 号

公司電話：0755-27766410 公司傳真：0755-22144774

香港分公司：香港九龙长沙湾京东街 31 号恒邦商务大厦

電話：852—35857483（20 線）　傳真：852—35857491

官方網站：www.aaaaahx.com　www.aaaaahx.cn

官方郵箱：sz@aaaaahx.com　aaaaahx@126.com

LS-555A 无铅低温锡膏

一、 LS-555A 无铅低温锡膏简介：

LS-555A 无铅低温锡膏由特殊无铅助焊剂与低氧化度的球形焊料粉末组成无铅环保，采用高性能触变剂，具有优越的溶解性和持续性，适用于细间距器件（QFP 等）的贴装。

二、 LS-555A 无铅低温锡膏特性

1．本产品为免清洗型，焊后残留物极少，无需清洗即达到优越的测试性能，及具有极高之表面绝缘阻抗。

2．连续印刷稳定，在长时间印刷后仍具有优异的脱膜性，可适用于细间距器件（0.4mm）的贴装。溶剂挥发慢，可长时间印刷而不会影响锡膏的印刷粘度。粘度适中且触变性好，印刷中和印刷后不易坍塌，显著减少焊接架桥之发生。

3．焊时具有优异的润湿性能，无锡球现象。有效改善短路之发生。焊后焊点光泽良好，导电性能优异。

三、LS-555A 无铅低温锡膏材料组成及其它

1：合金成份

项　　目	合　金　成　分
(Sn)锡含量	42%
(Bi)铋含量	58%

2：熔解温度及其它

融　　点	138 ℃
锡 粉 颗 粒 度	20～45um
锡 粉 的 形 状	球　形

3：助焊剂比例及粘度

助 焊 剂 含 量	9.5±0.5　wt %
粘　　度	200 Pa.s

四：LS-555A 无铅低温锡膏项目检测

项　　目	标准与测试方法	特　　性

铜板腐蚀试验	IPC－TM－650	无腐蚀
绝缘电阻试验	IPC－TM－650	$1\times10^{12}\Omega$ 以上
电 迁 移 性	IPC－J－STD－004A	无电迁移现象发生($5\times10^{12}\Omega$ 以上)
扩 散 率	JIS－Z－3197	93% 以上

表面绝缘阻抗按 IPC－TM－650 方法测试

（40℃ 90%RH）	168h	大于 1×1011Ω
（85℃ 85%RH）	168h	大于 5×109Ω

五：LS-555A 无铅低温锡膏环境

1.温度:18~25℃.

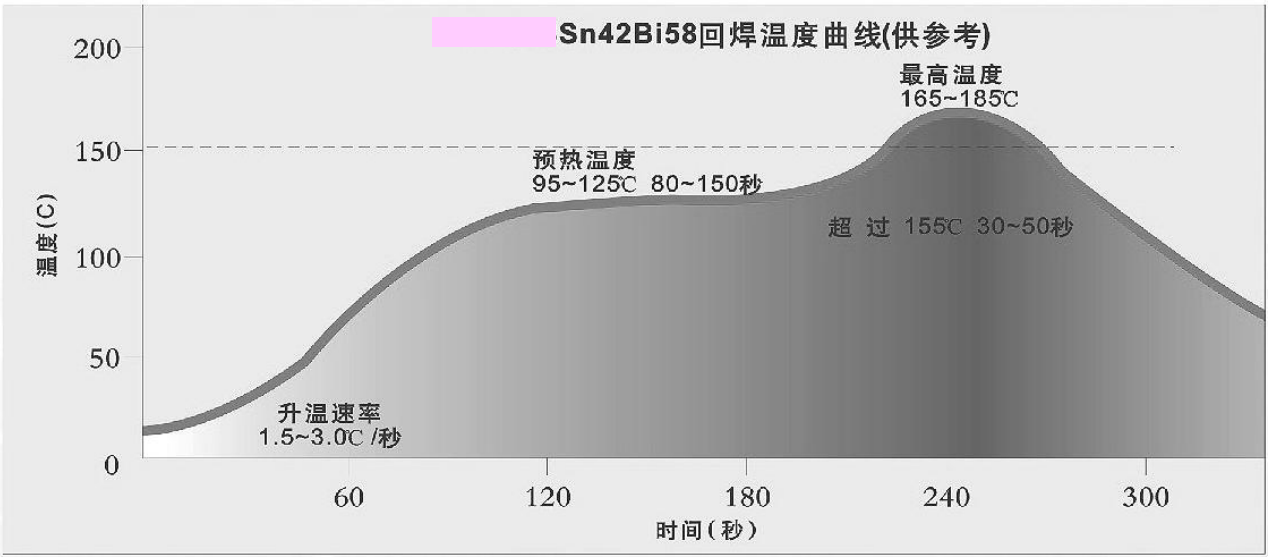
2.湿度:40~60%RH

六：LS-555A 无铅低温锡膏品质保证使用注意事项

品质保证期限为生产日起 6 个月内，但必须于 2-10℃密封保管，超过保存期限请做报废处理，以确保生产品质。使用前务必先使之回升至室温（25℃时需时约 2 小时），并搅拌 3-5 分钟后再使用，不建议储存的温度在 0℃以下,这样可能会危害锡膏的流动性。

七：LS-555A 无铅低温锡膏包装

容 器	包装净重
PE 制宽口型密封容器	500g

八：LS-555A 无铅低温锡膏回流曲线及熔锡注意事项

回焊曲线由锡膏的合金熔点和元件热传导性能而决定，下图是 LS-555A 低温无铅锡膏在使用中有较好效果的建议回焊温度曲线(供参考):